



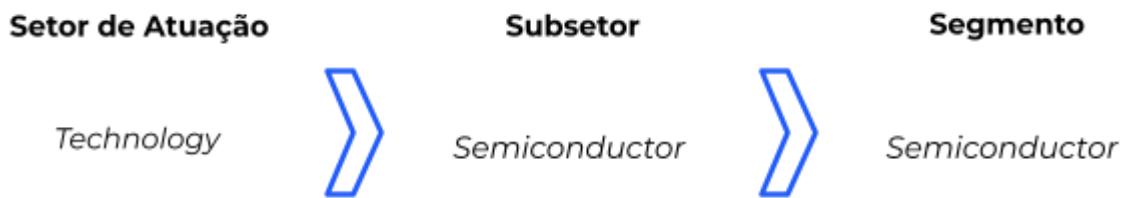
Análise

ASML Holding
ASML34 | ASML

Produzido por SIMPLA CLUB

Thiago Affonso Armentano

Área de Atuação



A **ASML Holding N.V.** é uma empresa holandesa líder mundial no fornecimento de sistemas de litografia para a indústria de semicondutores. Sua principal função é desenvolver e fabricar máquinas que permitem a produção de *microchips* cada vez menores, mais rápidos e eficientes, essenciais para dispositivos eletrônicos modernos.

Processos Operacionais:

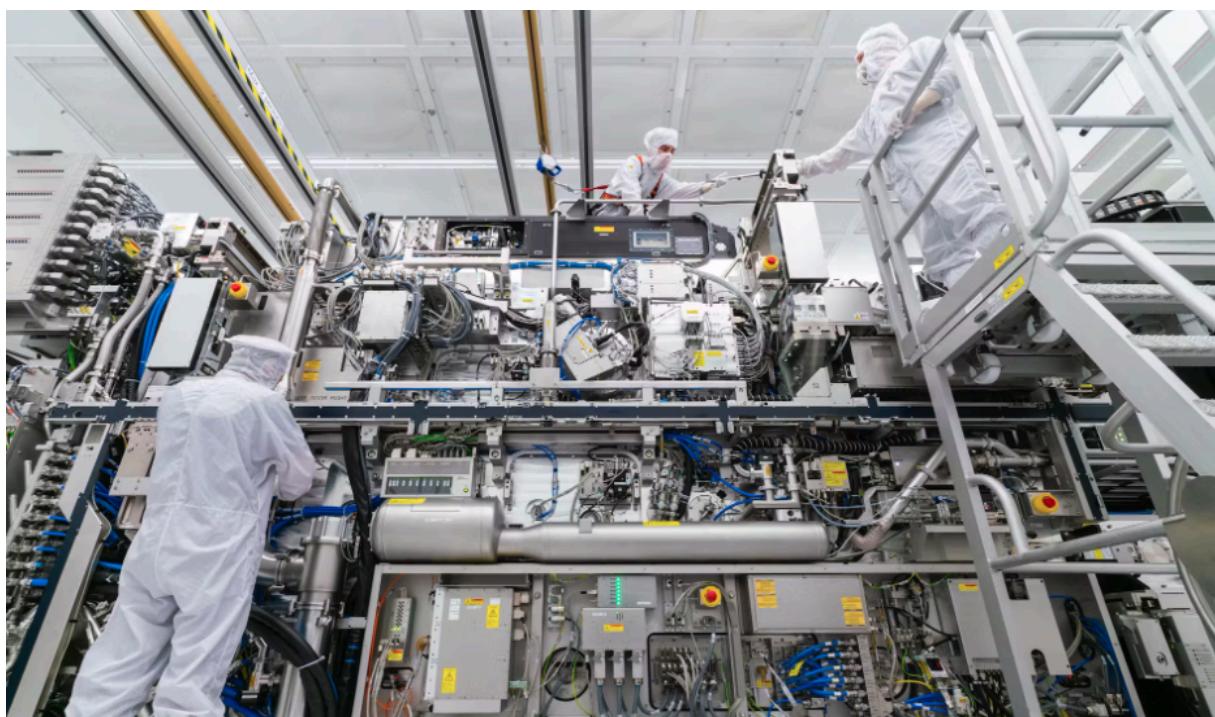
A operação da ASML é altamente complexa, envolvendo desde o **design e desenvolvimento de sistemas de litografia até a fabricação, montagem e suporte técnico**. A empresa possui uma cadeia de suprimentos global e colabora com diversos fornecedores para obter componentes de alta precisão necessários para suas máquinas. Além disso, a ASML oferece **serviços de manutenção e upgrades para seus sistemas instalados**, garantindo que os clientes mantenham a eficiência e a produtividade em suas linhas de produção.

Principais Tecnologias e Produtos:

- ❖ **Litografia Ultravioleta Extrema (EUV):** A ASML é pioneira na tecnologia EUV, que utiliza comprimentos de onda extremamente curtos para gravar circuitos em escalas nanométricas nos wafers de silício. Essa tecnologia é crucial para a produção de *chips* avançados utilizados em aplicações como inteligência artificial, 5G e computação de alto desempenho.

- ❖ **Litografia Ultravioleta Profunda (DUV):** Além do EUV, a ASML continua a aprimorar suas máquinas DUV, que são amplamente utilizadas na fabricação de uma variedade de semicondutores. Essas máquinas são essenciais para a produção em massa de *chips* em nós tecnológicos mais maduros.

A litografia ultravioleta extrema (EUV) é a tecnologia mais avançada no campo da fabricação de semicondutores, e a ASML é a pioneira nesse segmento. Essa técnica revolucionária utiliza luz com comprimento de onda de 13,5 nanômetros – consideravelmente menor do que os 193 nanômetros usados na litografia ultravioleta profunda (DUV).



Máquina de litografia da ASML.
Fonte: Elaboração Simpla Club.

Esse comprimento de onda reduzido é crucial para gravar padrões em escalas nanométricas nos wafers de silício, permitindo a produção de transistores cada vez menores, mais eficientes e mais rápidos. A **EUV desempenha um papel essencial na criação de chips que impulsionam**

aplicações de alto desempenho, como inteligência artificial (IA), redes 5G e computação de ponta.

Wafers são discos finos de material semicondutor, geralmente feitos de silício altamente puro, usados como substrato para a fabricação de circuitos integrados e outros dispositivos microeletrônicos. Esses discos funcionam como uma base sobre a qual são construídos os chips, com camadas de materiais e padrões gravados usando processos como a litografia. Cada wafer pode conter centenas ou até milhares de chips, dependendo do seu tamanho e do nó tecnológico utilizado.

Dentro desses chips, estão os **transistores, os blocos fundamentais dos circuitos integrados**. Eles atuam como interruptores ou amplificadores de corrente elétrica, controlando o fluxo de elétrons para realizar operações lógicas e armazenar informações digitais. Fabricados em escala nanométrica, bilhões de transistores podem ser gravados sobre um único wafer, permitindo a criação dos circuitos complexos que alimentam dispositivos como smartphones e computadores.



*Tecnologia ASML.
Fonte: Elaboração Simpla Club.*

O que desenha os *chips* nos *wafers* são ondas eletromagnéticas, no caso da litografia EUV, luz com um comprimento de onda extremamente curto. Para criar essa luz, a ASML utiliza um laser especial que atinge pequenas gotas de estanho líquido, transformando-as em plasma. Esse plasma emite ondas de alta frequência, que são direcionadas e controladas por espelhos super precisos. Como essa luz é absorvida pelo ar, tudo acontece em um

ambiente de vácuo. Assim, essas ondas eletromagnéticas desenham, com detalhes incrivelmente pequenos, os padrões que formam os *chips* nos *wafers*.

No centro desse processo estão as **máscaras de litografia**, que contêm os **padrões a serem gravados no wafer**. Elas precisam ser extremamente precisas e livres de defeitos, pois qualquer imperfeição pode comprometer a integridade do *chip*. O *wafer*, por sua vez, é revestido com um material fotorresistente que reage à luz EUV, permitindo que os padrões sejam gravados em alta resolução. A precisão é essencial; o alinhamento entre a máscara e o *wafer* deve ser controlado com tolerâncias subnanométricas, algo que só é possível devido aos sistemas avançados da ASML.

Papel na Cadeia de Valor de Semicondutores

A ASML desempenha um papel indispensável na cadeia de valor global de semicondutores. Seu impacto se estende desde o fornecimento de materiais básicos até o uso final em dispositivos eletrônicos e aplicações avançadas, conectando diversas indústrias e países em uma rede interdependente.

O impacto da ASML se manifesta nos setores finais que dependem dos semicondutores fabricados com suas máquinas. A indústria automotiva, por exemplo, está cada vez mais dependente de chips avançados para tecnologias como veículos autônomos e sistemas de assistência ao motorista (ADAS). Em paralelo, setores como eletrônicos de consumo e inteligência artificial requerem semicondutores de altíssimo desempenho para aplicações que vão desde *smartphones* até *data centers* e supercomputadores.

A tecnologia da ASML possibilita a miniaturização contínua de transistores, permitindo a criação de *chips* mais rápidos, eficientes e com maior densidade. Isso é fundamental para atender às demandas crescentes de

processamento e eficiência energética em aplicações como redes neurais, aprendizado de máquina e computação em nuvem.

Principais *Players*

Essa tecnologia desenvolvida pela ASML é fundamental para fabricantes como a TSMC, a maior *foundry* de semicondutores do mundo. A TSMC utiliza os sistemas EUV da ASML para produzir chips em nós tecnológicos avançados, como 7 nm, 5 nm e, mais recentemente, 3 nm. Por exemplo, no nó de 5 nm, a TSMC utiliza camadas de EUV para formar padrões complexos e altamente densos nos *chips*.

Esses avanços não apenas aumentam o número de transistores em um *chip*, mas também melhoram a eficiência energética e o desempenho – características fundamentais para aplicações em IA, dispositivos móveis e computação de alto desempenho.

Um exemplo prático da aplicação dessa tecnologia é o trabalho conjunto entre a TSMC e a NVIDIA. A NVIDIA projeta suas GPUs avançadas, como as da série RTX 4000, com base nos nós de fabricação da TSMC que utilizam litografia EUV.

Essas GPUs, baseadas na arquitetura Ada Lovelace, são fabricadas no nó de 5 nm e dependem da precisão e eficiência da EUV para alcançar densidades de transistores que suportem o alto desempenho exigido por inteligência artificial, renderização gráfica em tempo real e outras aplicações de computação intensiva. A EUV permite que a NVIDIA incorpore mais núcleos CUDA, unidades tensor e RT cores em suas GPUs, garantindo avanços significativos em desempenho e eficiência térmica.

Monopólio no Mercado de EUV

A tecnologia de litografia EUV é tão avançada e complexa que nenhuma outra empresa conseguiu desenvolver sistemas comparáveis para competir

diretamente com a ASML. A criação de uma máquina EUV exige domínio de múltiplas disciplinas de engenharia, incluindo óptica avançada, física de plasma, nanotecnologia e materiais especiais. A ASML investiu bilhões de euros para desenvolver essa tecnologia ao longo de anos, criando uma barreira de entrada praticamente intransponível para concorrentes.

Apesar da atual posição da ASML, iniciativas emergentes têm surgido com o objetivo de reduzir essa dependência tecnológica. Na China, empresas como SMEE e SiCarrier estão desenvolvendo protótipos de sistemas EUV, mas ainda enfrentam sérios entraves técnicos, não oferecendo, até o momento, soluções comerciais comparáveis em performance e escala.

Concorrência em Tecnologias Mais Maduras

Embora domine o mercado de EUV, a ASML enfrenta concorrência em tecnologias de litografia DUV (Deep Ultraviolet), utilizadas para nós tecnológicos menos avançados ou para aplicações específicas onde EUV não é economicamente viável. Os principais concorrentes neste segmento incluem:

- ❖ Nikon Corporation (Japão): Concorrente tradicional em litografia DUV. Apesar de ter perdido terreno nos nós mais avançados, a Nikon ainda é relevante em mercados específicos, como sensores de imagem.
- ❖ Canon Inc. (Japão): Também compete no segmento de DUV, mas com foco em mercados de menor complexidade tecnológica.

Apesar dessa concorrência, a ASML ainda é dominante no segmento de DUV, com uma participação de mercado maior do que a soma de Nikon e Canon.

○ **Futuro da Fabricação Avançada**

Próximos Passos da Indústria

A litografia EUV de alta potência (High-NA EUV) representa a próxima fronteira na fabricação de semicondutores, permitindo avanços ainda maiores na miniaturização e densidade dos transistores. Essa tecnologia utiliza sistemas ópticos com maior abertura numérica (Numerical Aperture, ou NA), um parâmetro que determina a capacidade de uma lente ou espelho de resolver detalhes finos. Isso é essencial para a produção de chips abaixo de 2 nm, o próximo marco na indústria de semicondutores.

Com o High-NA EUV, será possível eliminar ou reduzir a necessidade de técnicas de gravação múltipla (*multi-patterning*), que são complexas, caras e propensas a erros. Isso simplifica o processo de fabricação, reduz custos e melhora a precisão dos chips fabricados. Os sistemas também exigirão avanços em outros componentes, como espelhos e máscaras, que precisarão ser ainda mais refinados para lidar com as demandas da maior resolução.

Empresas como a ASML estão liderando o desenvolvimento do High-NA EUV, em parceria com fabricantes de semicondutores como TSMC, Intel e Samsung, que já planejam usar a tecnologia em suas linhas de produção. A transição para High-NA EUV também influenciará o *design de chips*, permitindo que empresas como NVIDIA e AMD criem arquiteturas ainda mais densas e eficientes, potencializando tecnologias como inteligência artificial, computação quântica e redes neurais.

No entanto, o High-NA EUV apresenta desafios significativos. O desenvolvimento de sistemas ópticos e fontes de luz mais potentes é tecnicamente complexo e caro. Além disso, a fabricação de máscaras para High-NA EUV exigirá novos materiais e processos para alcançar a precisão necessária. Apesar disso, a expectativa é que essa tecnologia comece a ser

implementada comercialmente em 2025, marcando uma nova era para a indústria de semicondutores e sustentando os avanços tecnológicos pelos próximos anos.

Tecnologias Disruptivas

Tanto a computação quântica quanto as redes neurais estão no centro de transformações tecnológicas que moldarão o futuro da indústria. Enquanto a **computação quântica ainda está em estágio inicial** e depende de técnicas de fabricação experimentais, **as redes neurais já são uma realidade** consolidada, sustentada pela capacidade das máquinas EUV da ASML de empurrar os limites da miniaturização.

A chegada da litografia High-NA EUV pode levar essas tecnologias a um novo patamar. Para redes neurais, ela permitirá a fabricação de chips ainda mais densos e eficientes, essenciais para os crescentes requisitos de inteligência artificial. Para a computação quântica, pode viabilizar avanços em semicondutores de suporte, que ajudarão a integrar processadores quânticos em sistemas híbridos de alto desempenho.

Redes Neurais

Redes neurais são modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro humano, compostos por camadas de nós (neurônios artificiais) interconectados que processam dados e aprendem padrões a partir deles. Utilizadas amplamente em inteligência artificial, elas são especialmente eficazes em tarefas como reconhecimento de voz e imagem, previsão de dados, tradução automática e detecção de anomalias.

Sua utilidade está em resolver problemas complexos e lidar com grandes volumes de dados de forma autônoma, tornando-as indispensáveis em áreas como saúde (diagnóstico de doenças), finanças (previsão de

mercados), transporte (condução autônoma) e tecnologia (assistentes virtuais e busca *online*).

As redes neurais demandam *hardware* especializado que seja capaz de realizar operações paralelas massivas de forma eficiente. Esses *chips*, conhecidos como aceleradores de IA, incluem GPUs (unidades de processamento gráfico), TPUs (unidades de processamento tensorial) e NPUs (unidades de processamento neural). A eficiência e o desempenho desses chips dependem de transistores extremamente densos e precisos, algo possível graças às máquinas de litografia EUV da ASML.

As máquinas EUV desempenham um papel crítico ao permitir que empresas como TSMC fabriquem *chips* nos nós tecnológicos mais avançados. Esses nós são usados para produzir GPUs da NVIDIA, TPUs do Google e outros processadores de IA. A alta precisão da litografia EUV permite gravar estruturas em escala nanométrica nos *wafers*, criando matrizes densas de transistores que realizam cálculos intensivos de aprendizado profundo.

História da Empresa

A ASML foi fundada em 1984, como uma *joint venture* entre a Philips e a ASM International, com o objetivo de comercializar sistemas de litografia para a indústria de semicondutores. Instalada em Veldhoven, na Holanda, iniciou suas operações de forma modesta, mas com forte base tecnológica herdada do laboratório de pesquisas Natlab, da Philips.

Em 1986, lançou seu primeiro produto comercial, o *stepper* PAS 2500, marcando sua entrada no mercado global. O crescimento ganhou tração em 1995, quando a empresa realizou seu IPO nas bolsas de Amsterdã e Nova York, representando o início de sua independência estratégica, com a Philips reduzindo significativamente sua participação acionária. No mesmo

ano, o lançamento da plataforma PAS 5500 consolidou sua presença como fornecedora relevante no setor.

No início dos anos 2000, a aquisição da americana Silicon Valley Group (SVG) foi estratégica para a entrada da ASML no desenvolvimento da litografia ultravioleta extrema (EUV), além de ampliar sua base de clientes nos Estados Unidos.

Após a crise da bolha pontocom, a empresa passou por reestruturação e voltou a crescer com o avanço da litografia de imersão, implementada com sucesso a partir de 2004.

Em 2012, para acelerar o desenvolvimento da tecnologia EUV, Intel, TSMC e Samsung investiram conjuntamente cerca de €3,9 bilhões na ASML, tornando-se acionistas minoritários. No mesmo ano, a empresa adquiriu a Cymer, sua principal fornecedora de fontes de luz, verticalizando sua cadeia de suprimentos crítica.

A aquisição da Hermes Microvision, em 2016, e da Berliner Glas, em 2020, fortaleceu suas capacidades em inspeção e óptica de precisão, complementando a oferta tecnológica. Entre 2018 e 2021, a ASML tornou-se a única fornecedora global de sistemas EUV, uma posição de mercado praticamente monopolista em um segmento de altíssimo valor agregado.

A partir de 2023, passou a enfrentar restrições à exportação de equipamentos para a China, reflexo das tensões geopolíticas entre Estados Unidos e o país. Ainda assim, lançou sua nova geração de máquinas High-NA EUV, com foco em processos abaixo de 3 nm.

Em abril de 2024, Christophe Fouquet assumiu como CEO, sucedendo Peter Wennink. A nova liderança assume o comando da companhia em um contexto desafiador, marcado por disputas geopolíticas, pressões regulatórias e escassez de talentos especializados.

Riscos do Negócio

A ASML está exposta a uma variedade de riscos que podem impactar significativamente suas operações, desempenho financeiro e posição competitiva. Esses riscos podem ser classificados em categorias estratégicas, operacionais, regulatórias e geopolíticas.

Um dos principais fatores de risco está relacionado à alta concentração tecnológica e dependência de poucos clientes. A empresa fornece sistemas de litografia altamente especializados, sendo atualmente a única no mundo a oferecer equipamentos EUV em escala comercial. Essa posição dominante, embora vantajosa, implica elevada dependência de um número limitado de clientes — especialmente TSMC e Samsung, que respondem por uma parcela significativa da receita consolidada.

Adicionalmente, a ASML opera em um ambiente geopoliticamente sensível, com riscos crescentes relacionados a exportações, sanções e restrições regulatórias. Desde 2023, o governo holandês — em alinhamento com os Estados Unidos — impôs restrições à exportação de sistemas avançados para a China, impactando diretamente o potencial de crescimento da empresa em um dos seus maiores mercados emergentes. Tais medidas aumentam a exposição a riscos políticos e reduzem a previsibilidade das receitas provenientes da Ásia.

No campo operacional, a empresa enfrenta riscos de cadeia de suprimentos, dada a complexidade e especificidade dos componentes utilizados em seus equipamentos. Muitas dessas peças são fornecidas por poucos parceiros, o que torna a ASML vulnerável a interrupções logísticas, escassez de materiais e restrições de capacidade de fornecedores estratégicos. O risco é agravado por eventos geopolíticos, desastres naturais e desafios regulatórios ambientais em diferentes jurisdições.

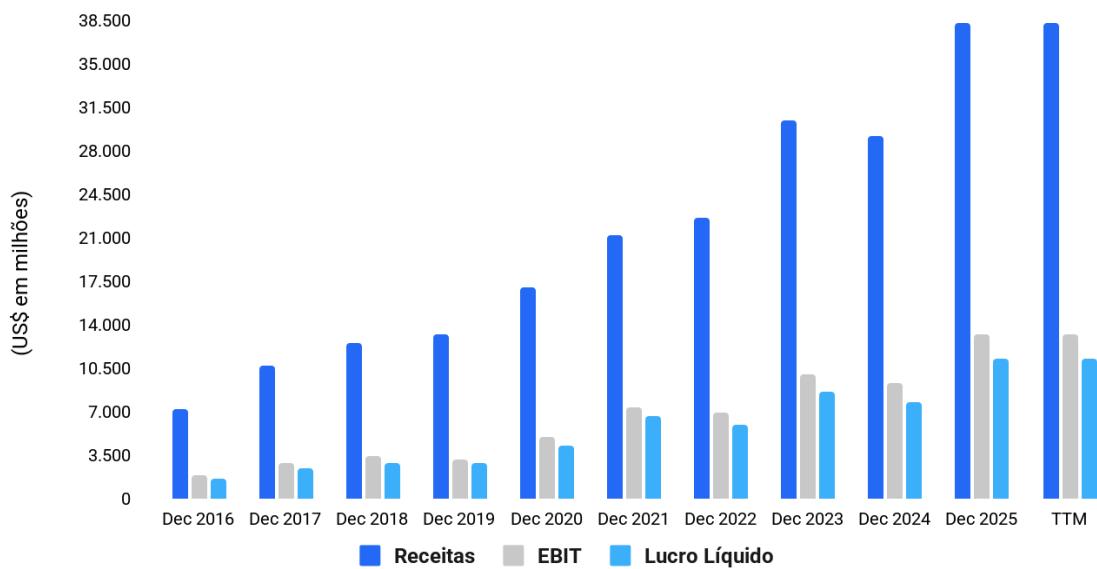
A empresa também está sujeita a riscos regulatórios e de conformidade, especialmente em temas relacionados a exportação de tecnologia, propriedade intelectual e leis antitruste. A não observância dessas normas pode levar a penalidades significativas, restrições operacionais e danos reputacionais. A ASML atua continuamente na gestão desses riscos por meio de programas de compliance, auditoria interna e cooperação ativa com órgãos reguladores.

Por fim, o ritmo acelerado da inovação em semicondutores representa um risco tecnológico. A empresa depende da contínua evolução de suas plataformas — como DUV, EUV e, mais recentemente, High-NA EUV — para sustentar sua liderança. Falhas em acompanhar as exigências tecnológicas dos clientes ou atrasos em roadmap de produto podem comprometer sua vantagem competitiva no longo prazo.

Resultados Anteriores

A ASML apresentou um crescimento de receita extraordinário ao longo da última década, consolidando-se como um ativo estrutural da cadeia global de semicondutores. Entre 2016 e o período de doze meses encerrados (TTM), o faturamento da companhia avançou de US\$7,2 bilhões para expressivos US\$38,3 bilhões.

Esse movimento representa um crescimento composto anual (CAGR) de 18,16%, ritmo bastante superior ao da maioria das empresas industriais globais. Tal desempenho foi impulsionado principalmente pela demanda crescente por chips de última geração, fundamentais para aplicações de Inteligência Artificial, computação em nuvem, *data centers* e dispositivos móveis de alta performance. Nesse contexto, a ASML ocupa uma posição única, sendo praticamente insubstituível no fornecimento de máquinas de litografia avançada.



Resultado operacional.

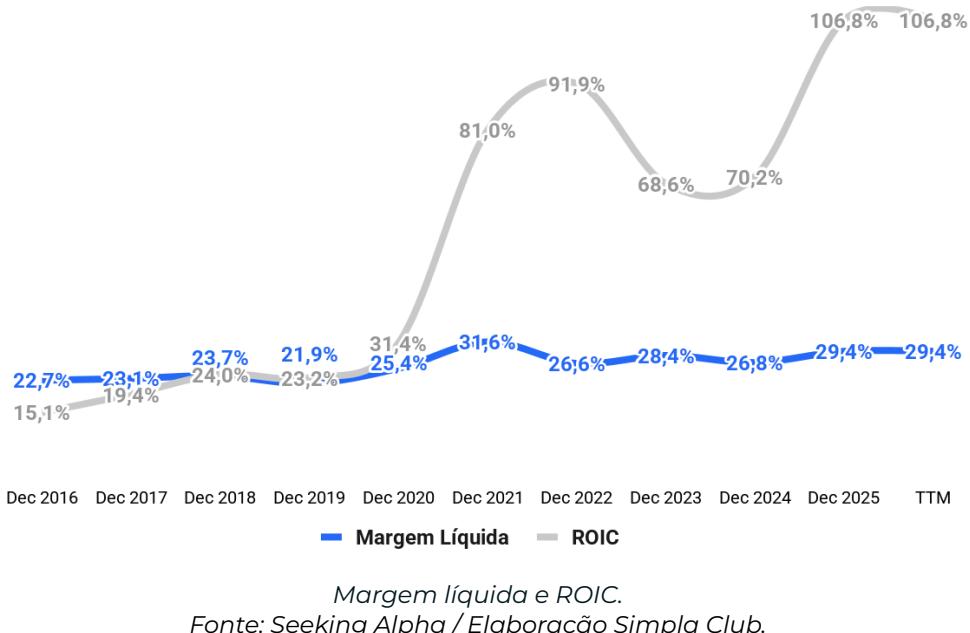
Fonte: Seeking Alpha / Elaboração Simpla Club.

A expansão da receita veio acompanhada de um crescimento ainda mais acelerado dos resultados operacionais. O EBIT e o lucro líquido registraram CAGRs de 21,78% e 21,28%, respectivamente, ao longo do período analisado. Em termos absolutos, o lucro líquido da companhia saltou de US\$1,6 bilhão em 2016 para US\$11,2 bilhões no TTM. Esse descolamento positivo entre crescimento de resultados e crescimento de receita evidencia uma forte alavancagem operacional, característica típica de modelos de negócio com elevado conteúdo tecnológico, altos custos fixos e significativa escalabilidade. À medida que o volume de vendas cresce, grande parte do incremento de receita se converte em lucro.

A análise das margens reforça o avanço estrutural da eficiência operacional da ASML. A margem bruta, que já era elevada em 2016 (45,7%), expandiu-se para 52,8% no TTM, refletindo o domínio tecnológico da companhia, especialmente no segmento de máquinas de litografia EUV, que possuem alto valor agregado, baixa concorrência e forte poder de precificação.

Na mesma direção, a margem líquida evoluiu de 22,7% para 29,4%, mantendo-se consistentemente em patamares elevados ao longo dos

anos. Esse comportamento sinaliza uma operação madura, altamente rentável e protegida por barreiras tecnológicas robustas, o que limita a pressão competitiva e sustenta retornos elevados no longo prazo.

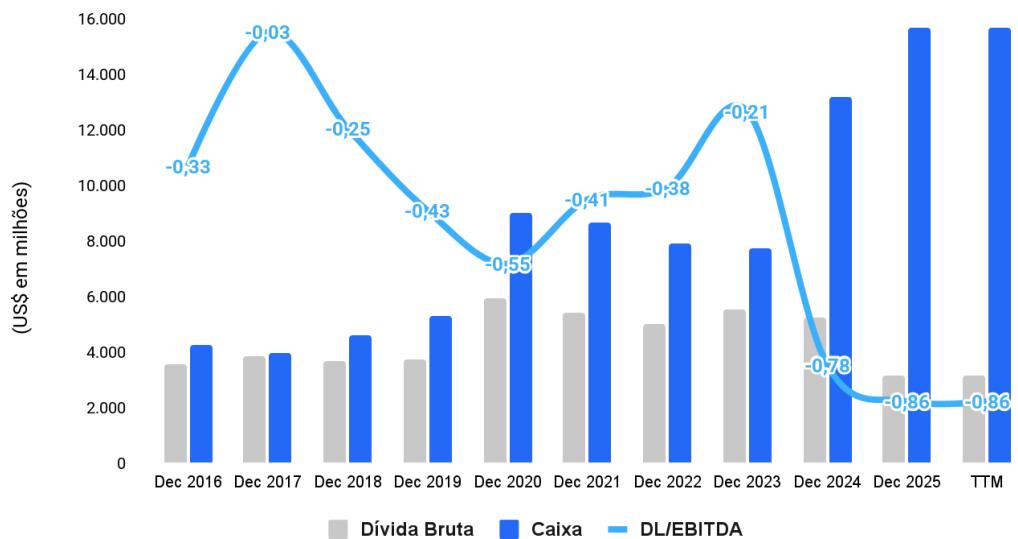


Considerando o modelo de negócios da ASML e sua estrutura de capital, utilizamos o Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) como principal métrica de rentabilidade. Diferentemente do ROE, o ROIC permite avaliar a eficiência da companhia na alocação de todo o capital empregado, incluindo capital próprio e dívida.

A evolução dessa métrica é particularmente impressionante: o ROIC avançou de 15,1% em 2016 para 106,8% no TTM. Esse patamar excepcional reflete, simultaneamente, a elevada eficiência operacional do negócio e os efeitos dos programas recorrentes de recompra de ações, que reduzem a base de capital e aumentam o retorno sobre os recursos efetivamente investidos.

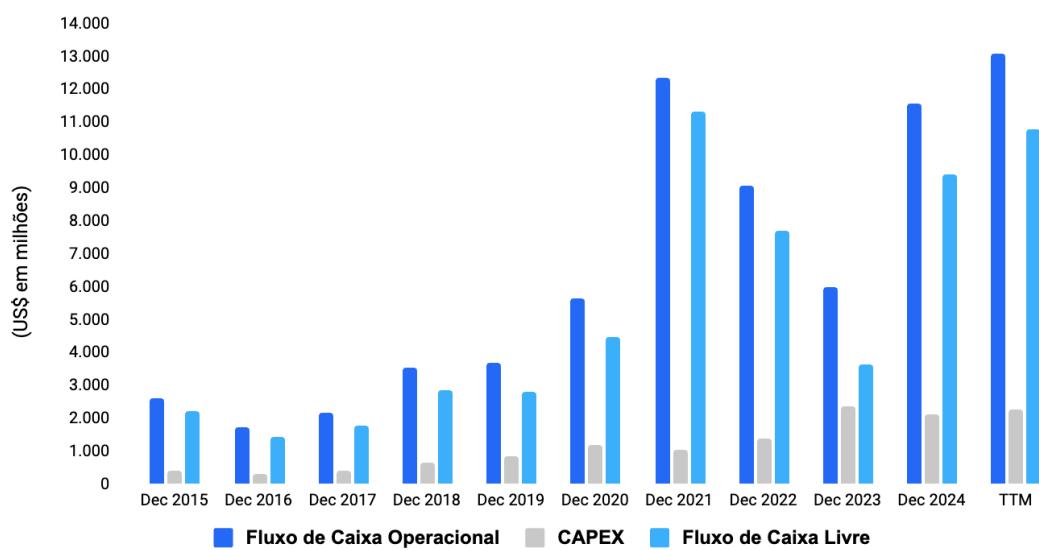
A estrutura financeira da ASML é extremamente sólida. No fechamento do TTM, a companhia apresentava US\$15,6 bilhões em caixa e equivalentes,

frente a uma dívida bruta de apenas US\$3,1 bilhões, configurando uma posição confortável de caixa líquido.



Nível de endividamento e caixa.
Fonte: Seeking Alpha / Elaboração Simpla Club.

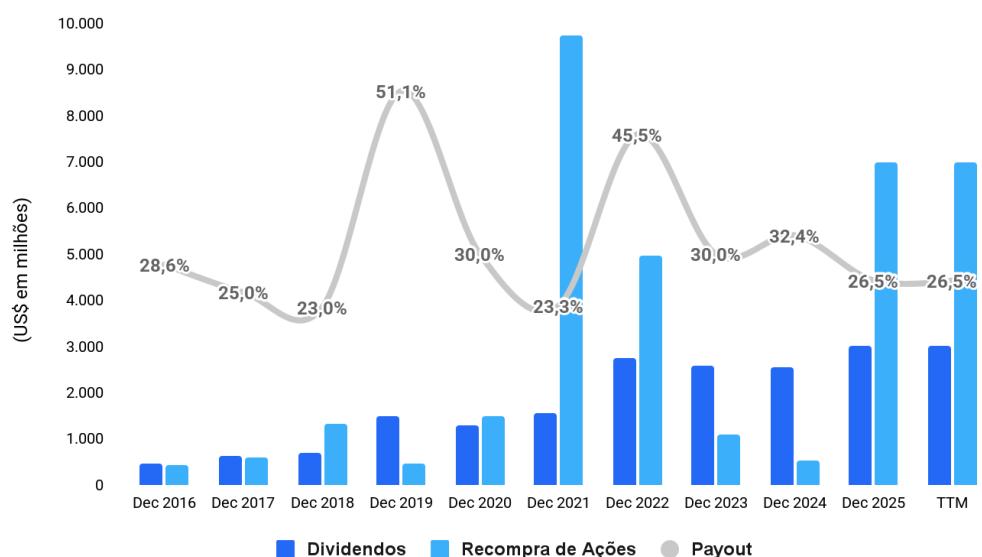
O indicador Dívida Líquida/EBITDA encontrava-se em -0,86x, evidenciando que a empresa possui recursos suficientes para quitar integralmente suas obrigações financeiras, mantendo ampla flexibilidade para investimentos, dividendos e recompras.



Geração de fluxo de caixa livre.
Fonte: Seeking Alpha / Elaboração Simpla Club.

Para avaliar a efetiva geração de recursos do negócio, analisamos o fluxo de caixa operacional e o Fluxo de Caixa Livre (FCF). O CAPEX representa os investimentos necessários para expansão e manutenção da capacidade produtiva, sendo subtraído do caixa operacional para chegarmos ao FCF.

No TTM, a ASML gerou US\$13,02 bilhões em fluxo de caixa livre, uma evolução expressiva frente aos US\$1,4 bilhão registrados em 2016. Essa métrica é central para a análise da companhia, pois é a partir dela que são financiados dividendos, recompras de ações e novos investimentos, sem comprometer a liquidez ou elevar o risco financeiro.



Dividendos, recompra de ações e payout.
Fonte: Seeking Alpha / Elaboração Simpla Club.

A ASML mantém uma política consistente e disciplinada de retorno ao acionista. Os dividendos distribuídos cresceram de forma recorrente ao longo do período analisado, passando de US\$469 milhões em 2016 para US\$2,9 bilhões no TTM. O payout permaneceu em níveis saudáveis, encerrando o período em 26,5%, o que garante espaço para reinvestimentos e preserva a sustentabilidade da política de dividendos.

Além disso, a companhia utiliza recompras de ações como um importante mecanismo de criação de valor. Em 2021, o volume de *buybacks* atingiu o

pico de US\$9,7 bilhões, enquanto o TTM totalizou US\$6,9 bilhões. Essa estratégia reduz o número de ações em circulação, elevando o lucro por ação e aumentando a participação dos acionistas remanescentes no negócio, reforçando a tese de geração de valor no longo prazo.

Opinião do Analista

A ASML ocupa uma posição estratégica única no setor de semicondutores, sendo atualmente a única fornecedora de sistemas de litografia EUV e uma das líderes em soluções avançadas de *patterning*. A companhia se beneficia de barreiras de entrada elevadas, poder de especificação relevante e uma base de clientes formada pelos maiores fabricantes globais. Seu portfólio inclui tecnologias de ponta, como o High-NA EUV, que pode ampliar a capacidade de miniaturização e eficiência na produção de *chips*, favorecendo o crescimento nos próximos ciclos tecnológicos.

No aspecto financeiro, a empresa apresenta fundamentos relevantes, com margens elevadas e geração consistente de caixa, sustentadas por vendas de novos sistemas, serviços e atualizações da base instalada. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento permanecem elevados, com foco na evolução do High-NA e expansão da capacidade produtiva global.

Os principais riscos envolvem a concentração de receita em poucos clientes, a natureza cíclica do setor, potenciais atrasos na adoção industrial do High-NA, restrições de exportação para mercados relevantes, como o chinês, e a influência de um custo de capital mais alto no momento.

Por outro lado, a demanda por sistemas de litografia avançados pode se mostrar mais resiliente que o previsto, especialmente se a adoção do High-NA ocorrer de forma mais acelerada, impulsionada por compromissos de clientes, como a TSMC. Eventuais melhorias no ambiente geopolítico, incluindo flexibilizações nas restrições à China, também poderiam acelerar

a carteira de pedidos e gerar novas oportunidades, além do potencial de novas fábricas na Índia e Sudeste Asiático.

A companhia mantém um *backlog* robusto, vantagem tecnológica consolidada e exposição a tendências estruturais como inteligência artificial e computação de alto desempenho. Considerando esses fatores, vemos a companhia bem posicionada no longo prazo, mesmo que o *valuation* possua pouca margem de segurança no momento. Desta forma mantemos uma visão positiva, com recomendação de compra para as ações da ASML (ASML).

Equipe

**Carlos Júnior**

Analista CNPI especialista em
Fundos Imobiliários

**Thiago Armentano**

Analista CNPI especialista em
Ativos Globais

**Guilherme La Vega**

Analista CNPI especialista em
Ações Brasileiras

Acompanhamento

relatório atualizado em 10.02.2026

Nossa equipe de analistas está atenta a todas as movimentações relevantes, mantendo os rankings e seus respectivos fundamentos atualizados todas as semanas. Em caso de grandes mudanças, os relatórios também podem ser atualizados. Já em caso do ativo receber recomendação de venda, nossa sugestão se refere, única e exclusivamente, à retirada do ativo da carteira do investidor, uma vez que não incentivamos a prática de venda à descoberto.

Disclaimer

Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo Thiago Affonso Armentano - CNPI EM-8454, com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, Os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório (e/ou seus cônjuges ou companheiros) são, ou podem ser, titulares de valores mobiliários objeto do relatório, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros. Na emissão deste relatório, a Simpla Invest, controladora do Simpla Club, poderá estar agindo em conflito de interesses em relação ao emissor, podendo (i) ter interesses financeiros e/ou comerciais relevantes e/ou (ii) estar envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório. A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.

